

取引先様各位

2025 年 10 月 吉日
エルナープリントドサーキット株式会社
代表取締役社長 楊 其 筠

社名変更に関するお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
このたび弊社は、2026 年 1 月 1 日付で、社名を下記の通り変更することとなりましたので、お知らせ致します。

新社名：リンクステック EPC 株式会社
〔Lincstech EPC CO.,LTD.〕
(旧社名：エルナープリントドサーキット株式会社
〔ELNA PRINTED CIRCUITS CO.,LTD.〕
※所在地、電話番号、法人番号等に変更はございません。

弊社は 1960 年よりプリント基板製造・販売の事業活動を行って参りましたが、今回の社名変更は、弊社の親会社である Global Brands Manufacture Ltd. (以降、GBM 社) のグループ戦略の一環として、同じく GBM 社を親会社に持つリンクステック株式会社 (1964 年よりプリント基板事業開始) とのブランド統一を図り、より一層のシナジー創出とグループ全体のプレゼンス向上を目的としています。今後も、社会やお客様・各取引先様及び従業員の満足度を高めるとともに、業界のリーディングカンパニーを目指すべくグループ一丸となって邁進して参ります。

なお、本件は社名変更のみであり、資本関係や経営体制に変更は一切ございません。これまで通り、従来の体制・サービス内容にて事業を継続して参ります。貴社との契約・協定・業務上のコミットメント等についても全て新社名にて継承致しますので、有効性に一切の影響はございません。
但し、正式に新社名に変更後、必要な書類の提出や手続きについては適宜対応させていただきますので、お気軽に弊社までご連絡下さい。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

また、別紙ご案内の通り、弊社マレーシア工場は 2025 年 11 月 1 日付で社名変更を行う予定です。

新社名：Lincstech Circuit Malaysia Sdn. Bhd.

敬具